



**Università degli Studi di Bergamo**

---

**SCUOLA DI INGEGNERIA**

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica  
Classe n. L-8 Ingegneria dell'informazione (D.M. 270/04)

## **Studio della tolleranza alle radiazioni ionizzanti di MOSFET in tecnologia 28nm**

Candidati

**Nicola Cattaneo**

Matricola 1081073

**Emilio Meroni**

Matricola 1080976

Relatore

**Prof. Gianluca Traversi**

---

**Anno Accademico 2023–2024**



# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>1</b>
1.1	Effetti delle radiazioni sui MOSFET . . . . .	1
1.1.1	Ionizzazione . . . . .	1
1.1.2	Misurazione Dose subita . . . . .	2
1.1.3	Danno da spostamento . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Estrazione dei parametri statici</b>	<b>3</b>
2.1	Tensione di soglia . . . . .	3
2.1.1	TCM . . . . .	4
2.1.2	SDLM . . . . .	10
2.1.3	ELR . . . . .	14
2.1.4	RM . . . . .	18
2.2	$G_m$ . . . . .	23
2.3	$G_{ds}$ . . . . .	23
2.4	$I_{on}$ . . . . .	23
2.5	$I_{off}$ . . . . .	23
2.6	Guadagno Intrinseco . . . . .	23



# Abstract



# Capitolo 1

## Introduzione

In questo capitolo si cercano di dare le informazioni principali sugli strumenti utilizzati e sulle cause degli effetti che analizzeremo nei capitoli successivi.

Cambiare il titolo del capitolo(?)

Fare una introduzione al capitolo

### 1.1 Effetti delle radiazioni sui MOSFET

Gli effetti delle radiazioni sui MOSFET possono essere principalmente di due categorie[3]:

- Ionizzazione, generazione di coppie elettroni-lacune( $e - h$ )
- Danni da spostamento, dislocazione degli atomi dai loro siti reticolari.

Il passaggio di una particella ionizzante, all'interno della materia, comporta una perdita di energia. Questo dissipamento può essere formalizzato come:

$$\Delta E = \Delta E_{\text{elettronica}} + \Delta E_{\text{nucleare}}$$

Perdita di energia elettronica e perdita di energia nucleare, la prima è dovuta dalle interazioni con gli elettroni negli atomi, mentre la seconda è causata dalle interazioni con i nuclei degli atomi. Gran parte dell'energia persa è elettronica, occasionalmente avvengono *collisioni forti* (hard collision) tali da creare frammenti nucleari, pertanto la perdita di energia totale è una buona approssimazione della perdita dell'energia elettronica[1].

#### 1.1.1 Ionizzazione

La perdita di energia elettronica nei semiconduttori provoca la ionizzazione, creazione di coppie elettrone-lacuna ( $e - h$ ). Il numero di  $e - h$  è proporzionale all'energia elettronica persa da parte della particella (per il silicio la costante è di  $1/3,6\text{eV}$  mentre per  $\text{SiO}_2$  è di  $1/18\text{eV}$  [1]).

L'effetto di ionizzazione è diverso nei semiconduttori e nei isolanti, una differenza è che l'effetto si accumuli o si dissipi rapidamente. Negli isolanti, come l'ossido di gate nei MOS, è presente l'effetto cumulativo. Gli elettroni liberati da una particella ionizzante si possono muovere più facilmente soprattutto grazie a effetti di campo dovuti, ad esempio,

a polarizzazioni. Al contrario i buchi(holes) sono molto meno mobili, la maggior parte di essi sopravvivono alla ricombinazione con gli elettroni. Creando perciò una carica positiva all'interno dell'ossido, con uno degli effetti di spostare la tensione di soglia nei MOSFET.

La ricottura dell'ossido (*oxide anneals*) è una procedura volta a ripristinare, almeno in parte, le caratteristiche del MOSFET a seguito di dose subita. Consiste nel neutralizzare i buchi scaldando il dispositivo, ad esempio, la procedura di annealing che abbiamo eseguito sui nostri dispositivi è stata di portarli ad una temperatura di  $100^{\circ}\text{C}$  e mantenerla per ventiquattro ore. La ricottura può avvenire anche a temperatura ambiente, ma probabilmente i tempi sarebbero molto lunghi, anche anni[1].

### 1.1.2 Misurazione Dose subita

Per effettuare la misurazione della ionizzazione accumulata si utilizza somma dell'energia persa, da parte delle particelle ionizzanti, sul materiale. Quindi in buona approssimazione, l'energia totale creata dalle interazioni con gli elettroni degli atomi alla materia e le particelle, è una misura della dose subita[1]. Essa viene chiamata TID (*total ionizing dose*) ed è espressa in Energia su unità di massa. La TDI normalmente è misurata in  $\text{rad}^1$ , definito come  $100 \text{ erg}^2$  per grammo di materiale, oppure, accolto dal sistema internazionale, il gray  $Gy$  dove  $Gy = 100\text{rad} = 1 \frac{J}{Kg}$ .

Non ha effetti  
sui MOSFET

### 1.1.3 Danno da spostamento

Quando una particella (neutrone, protone o anche elettrone ad alta energia) possiede abbastanza energia tale da poter dislocare un atomo al di fuori dalla sua posizione normale all'interno reticolo, in un semiconduttore, avviene il danno da spostamento (*Displacement damage*), in particolare dal movimento dell'atomo all'interno del semiconduttore. Può verificarsi che l'atomo colpito ne colpisca altri, a patto che abbia abbastanza energia, a sua volta[3].

Il danno da spostamento dipende dall'energia della particella, in particolare i protoni, avendo una massa maggiore, consentono di trasferire all'atomo colpito una energia maggiore rispetto ai elettroni[2].

---

<sup>1</sup>radiation absorbed dose

<sup>2</sup>Unità di lavoro corrispondente a  $10^{-7} J$



# Capitolo 2

## Estrazione dei parametri statici

In questo capitolo si tratteranno i parametri statici di transistori *MOS* in tecnologia *28nm* per comprendere come variano le prestazioni statiche all'aumentare dell'irraggiamento subito. Si tratteranno:

Aggiungere i  
parametri statici  
che studieremo

- Tensione di soglia
- Transconduttanza
- $G_{ds}$
- $I_{on}$
- $I_{off}$
- Guadagno Intrinseco

### 2.1 Tensione di soglia

La tensione di soglia  $V_{th}$  di un transistor MOS è definita come quella tensione tra gate e bulk per la quale la popolazione di minoritari all'interfaccia è uguale alla popolazione di maggioritari nel bulk. Questa definizione non può essere usata direttamente per il calcolo della tensione di soglia dei dispositivi, ma si deve passare attraverso l'analisi delle caratteristiche corrente-tensione dei dispositivi.

Per l'estrazione del parametro  $V_{th}$  esistono numerosi metodi[4], la scelta è solitamente dettata da un compromesso che si deve trovare fra complessità della procedura di estrazione della soglia e risultato ottenuto per la specifica applicazione. Per questo studio sono stati presi in considerazione:

- *Transconductance Change Method (TCM)*;
- *Second Difference of the Logarithm of the drain current Minimum method (SDLM)*;
- *Extrapolation in the Linear Region method (ELR)*;
- *Ratio Method (RM)*.

Per il nostro studio, però, non si è solo interessati al valore in sé della tensione di soglia dei dispositivi, ma anche a come questa varia all'aumentare dell'irraggiamento. Dunque, per ogni metodo non ci si ferma all'estrazione della  $V_{th}$  dei dispositivi non irraggiati, ma la si estrae anche dopo ogni step d'irraggiamento e, per ciascuno di questi, si calcola la  $\Delta V_{th} = V_{th,Irraggiato} - V_{th,nonIrraggiato}$ . La scelta di quale metodo usare per le analisi successive viene presa sulla qualità del parametro  $\Delta V_{th}$ .

### 2.1.1 Transconductance Change Method

Il *Transconductance Change Method*, *TCM*, definisce la tensione di soglia come la tensione di gate-source  $V_{GS}$  corrispondente al picco massimo della derivata della transconduttanza  $g_m$  rispetto alla tensione di gate ( $\frac{dg_m}{dV_{GS}}$ ) ed è valido per bassi valori della tensione  $V_{DS}$ .

Questa definizione si basa sul fatto che, quando il dispositivo passa dalla regione di debole inversione alla regione di forte inversione, la dipendenza della corrente di drain rispetto a  $V_{GS}$  passa dall'essere esponenziale all'essere lineare. La transconduttanza è definita come la derivata prima della corrente  $I_D$  rispetto alla tensione  $V_{GS}$ , dunque la derivata della  $g_m$  corrisponde alla derivata seconda di  $I_D$ . Per questo motivo, il massimo di  $\frac{dg_m}{dV_{GS}}$  coincide con la tensione alla quale il grafico della corrente passa dalla forma esponenziale a quella lineare. Se  $V_{DS}$  è piccola, la tensione per la quale la  $g_m$  è massima è molto simile a  $V_{th}$ .

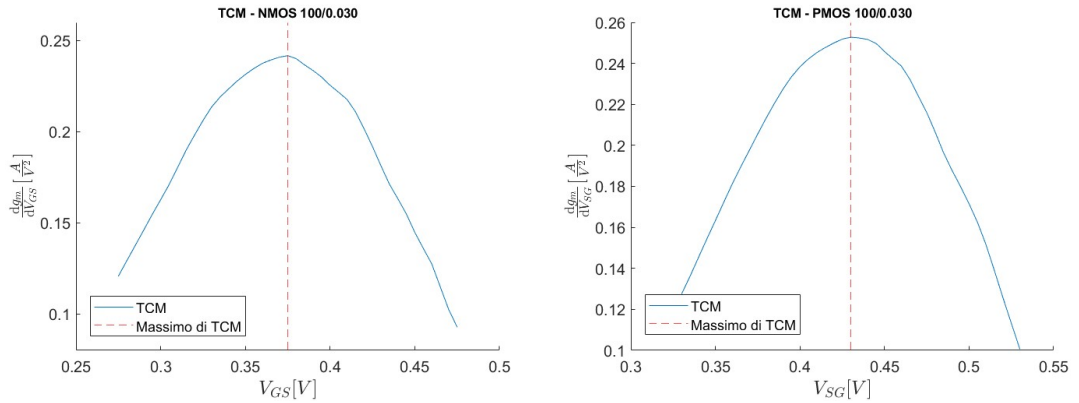


Figura 2.1: Esempio di *TCM* usato su un dispositivo NMOS e un dispositivo PMOS di dimensioni 100-0.030 a  $V_{DS} = 150mV$

Per calcolare il *TCM* si deve trovare il massimo di una funzione, ovvero calcolarne la derivata prima. In questo caso si tratta in realtà di una derivata seconda, essendo già  $g_m$  calcolato con una derivata. Il calcolo della derivata non è effettuato su una funzione continua ma su dati misurati con uno step di  $5mV$  di  $V_{GS}$ . Questo fa sì che la derivata prima e in modo maggiore la derivata seconda, siano affette da vere e proprie variazioni repentine dovute alla natura granulare dei dati e non da fenomeni fisici. È quindi necessario rendere la funzione studiata meno dipendente da questo effetto. Inoltre, come

detto in precedenza, la risoluzione con la quale sono state fatte le misure della corrente di drain è  $5mV$  (di  $V_{GS}$ ). Pertanto, con questo metodo si estrarrebbe una soglia che avrebbe una risoluzione di  $5mV$ , del tutto inaccettabile in quanto sarebbe maggiore delle variazioni di soglia che potrebbero essere indotte dall'irraggiamento. Per far fronte a questi due problemi, si è scelto di non tenere conto del massimo direttamente ottenuto dallo studio di  $\frac{dg_m}{dV_{GS}}$  ottenuto dai valori delle misure, ma d'interpolare prima i punti del grafico con una funzione polinomiale e, di ricavare il valore di soglia da questa funzione.

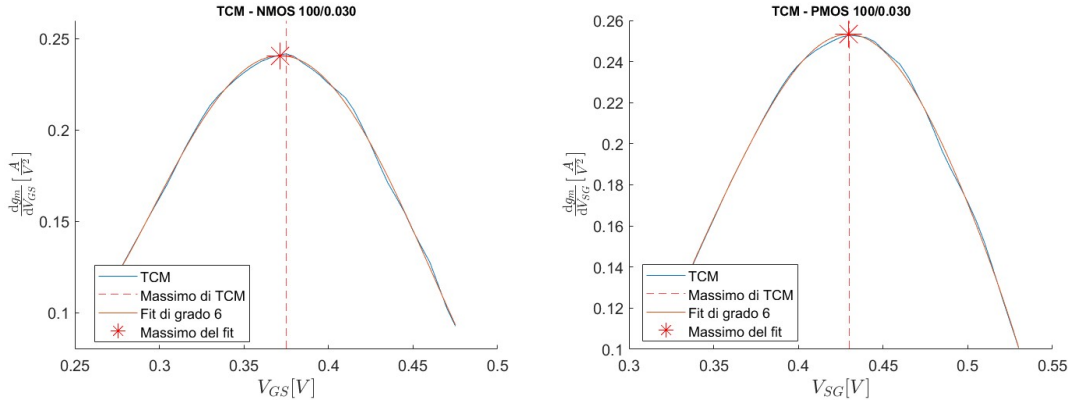


Figura 2.2: Esempio di *TCM* con fit polinomiale usato su un dispositivo NMOS e un dispositivo PMOS di dimensioni 100-0.030 a  $V_{DS} = 150mV$

Lo studio del fit polinomiale risolve il problema della bassa risoluzione di misura, ma presenta una potenziale nuovo problema: il valore della  $V_{th}$  calcolata potrebbe variare significativamente al variare del grado della funzione polinomiale interpolante. Per capire l'effetto del grado della funzione interpolante sul valore di tensione di soglia estratto, si sono effettuate le estrazioni considerando i gradi 2, 4, 6 e 8 e si sono studiati i risultati ottenuti. Lo studio si è effettuato su dispositivi PMOS. Una volta scelto il valore del grado della funzione, lo stesso grado sarà utilizzato anche per l'estrazione della tensione di soglia degli NMOS.

Osservando i valori nella tabella 2.1, si può notare che la tensione di soglia ottenuta non varia molto nel caso dei fit fatti con polinomiali di grado 4, 6 e 8: è raro che la differenza tra questi valori superi  $1mV$ . Non si può dire la stessa cosa per le  $V_{th}$  calcolate con fit di grado 2: in questo caso la funzione interpolante ha un grado troppo basso per seguire in modo coerente la curva  $\frac{dg_m}{dV_{GS}}$  e quindi il massimo risulta essere molto diverso da quelli calcolati con fit di grado maggiore. Dunque, al fine di fittare al meglio la curva, si è scelto un fit polinomiale di grado 6. In Tabella 2.2 e 2.3 sono riportati i risultati ottenuti con il metodo *TCM* e fit polinomiale di grado 6 su dispositivi PMOS e NMOS pre e post irraggiamento. Mentre nelle tabelle 2.4, 2.5 e nei grafici a figura 2.3 vengono riportati i valori della  $\Delta V_{th}$  in funzione della dose assorbita.

Dispositivo	$V_{th}[mV]$ con interpolante di grado:			
	2	4	6	8
100 - 0.030	426.9	429.4	429.4	430.8
100 - 0.060	467.6	469.5	469.3	468.9
200 - 0.030	397.8	399.7	399.3	399.8
200 - 0.060	452.2	454.1	453.5	453.5
200 - 0.180	495.6	495.6	495.3	495.5
600 - 0.030	383.0	387.4	385.9	386.2
600 - 0.060	431.1	434.3	434.7	435.6
600 - 0.180	478.5	480.8	480.6	480.0

Tabella 2.1: Confronto dei valori di  $V_{th}$  dei dispositivi PMOS ottenuti con *TCM* con fit polinomiale di diversi gradi

Dispositivo	$V_{th}[mV]$								
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad	3Grad	annealing
100 - 0.030	371.3	370.6	361.0	380.6	378.7	375.1	371.1	367.1	372.4
100 - 0.060	405.0	399.9	390.0	419.8	418.8	414.0	412.8	416.6	421.6
100 - 0.180	476.0	472.4	459.5	491.9	491.2	492.0	491.1	501.9	508.6
200 - 0.030	359.5	357.9	348.1	369.2	367.0	363.8	361.7	363.6	368.5
200 - 0.060	402.2	398.3	385.0	415.5	413.7	412.3	411.0	416.7	423.0
200 - 0.180	466.4	463.5	451.8	484.6	483.8	486.5	487.0	500.3	510.1
600 - 0.060	370.2	364.4	359.3	379.5	381.0	378.1	377.2	380.1	386.7
600 - 0.180	449.6	447.9	430.7	458.8	458.4	458.9	458.4	469.2	478.5

Tabella 2.2:  $V_{th}$  dei dispositivi NMOS estratte con *TCM*

## 2.1 Tensione di soglia

Dispositivo	$V_{th}[mV]$								
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad	3Grad	annealing
100 - 0.030	429.4	430.7	432.2	434.4	439.0	452.6	459.4	485.6	465.2
100 - 0.060	469.3	469.6	471.4	472.7	479.7	491.8	500.8	533.0	513.4
200 - 0.030	399.3	401.0	403.1	404.8	410.2	422.3	429.8	450.1	431.1
200 - 0.060	453.5	455.2	456.2	458.6	463.8	476.9	485.8	514.9	493.6
200 - 0.180	495.3	497.1	503.9	506.5	511.3	524.1	535.3	576.2	557.6
600 - 0.030	385.9	386.6	388.8	391.0	394.5	405.5	412.3	436.5	416.2
600 - 0.060	434.7	435.4	438.5	438.9	445.6	458.4	467.8	500.4	478.9
600 - 0.180	480.6	481.5	483.7	486.0	492.0	507.2	519.6	564.1	537.1

Tabella 2.3:  $V_{th}$  dei dispositivi PMOS estratte con *TCM*

Dispositivo	$\Delta V_{th}[mV]$							
	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad	3Grad	annealing
100 - 0.030	-0.7	-10.3	9.3	7.4	3.8	-0.2	-4.2	1.1
100 - 0.060	-5.1	-15.0	14.8	13.8	9.0	7.8	11.6	16.6
100 - 0.180	-3.6	-16.5	15.9	15.2	16.0	15.1	25.9	32.6
200 - 0.030	-1.6	-11.4	9.7	7.5	4.3	2.2	4.1	9.0
200 - 0.060	-3.9	-17.2	13.3	11.5	10.1	8.8	14.5	20.8
200 - 0.180	-2.9	-14.6	18.2	17.4	20.1	20.6	33.9	43.7
600 - 0.060	-5.8	-10.9	9.3	10.8	7.9	7.0	9.9	16.5
600 - 0.180	-1.7	-18.9	9.2	8.8	9.3	8.8	19.6	28.9

Tabella 2.4:  $\Delta V_{th}$  dei dispositivi NMOS estratte con *TCM*

Dispositivo	$\Delta V_{th}[mV]$							
	<i>5Mrad</i>	<i>50Mrad</i>	<i>100Mrad</i>	<i>200Mrad</i>	<i>600Mrad</i>	<i>1Grad</i>	<i>3Grad</i>	annealing
100 - 0.030	1.3	2.8	5.0	9.6	23.2	30.0	56.2	35.8
100 - 0.060	0.3	2.1	3.4	10.4	22.5	31.5	63.7	44.1
200 - 0.030	1.7	3.8	5.5	10.9	23.0	30.5	50.8	31.8
200 - 0.060	1.7	2.7	5.1	10.3	23.4	32.3	61.4	40.1
200 - 0.180	1.8	8.6	11.2	16.0	28.8	40.0	80.9	62.3
600 - 0.030	0.7	2.9	5.1	8.6	19.6	26.4	50.6	30.3
600 - 0.060	0.7	3.8	4.2	10.9	23.7	33.1	65.7	44.2
600 - 0.180	0.9	3.1	5.4	11.4	26.6	39.0	83.5	56.5

Tabella 2.5:  $\Delta V_{th}$  dei dispositivi PMOS estratte con *TCM*

## 2.1 Tensione di soglia

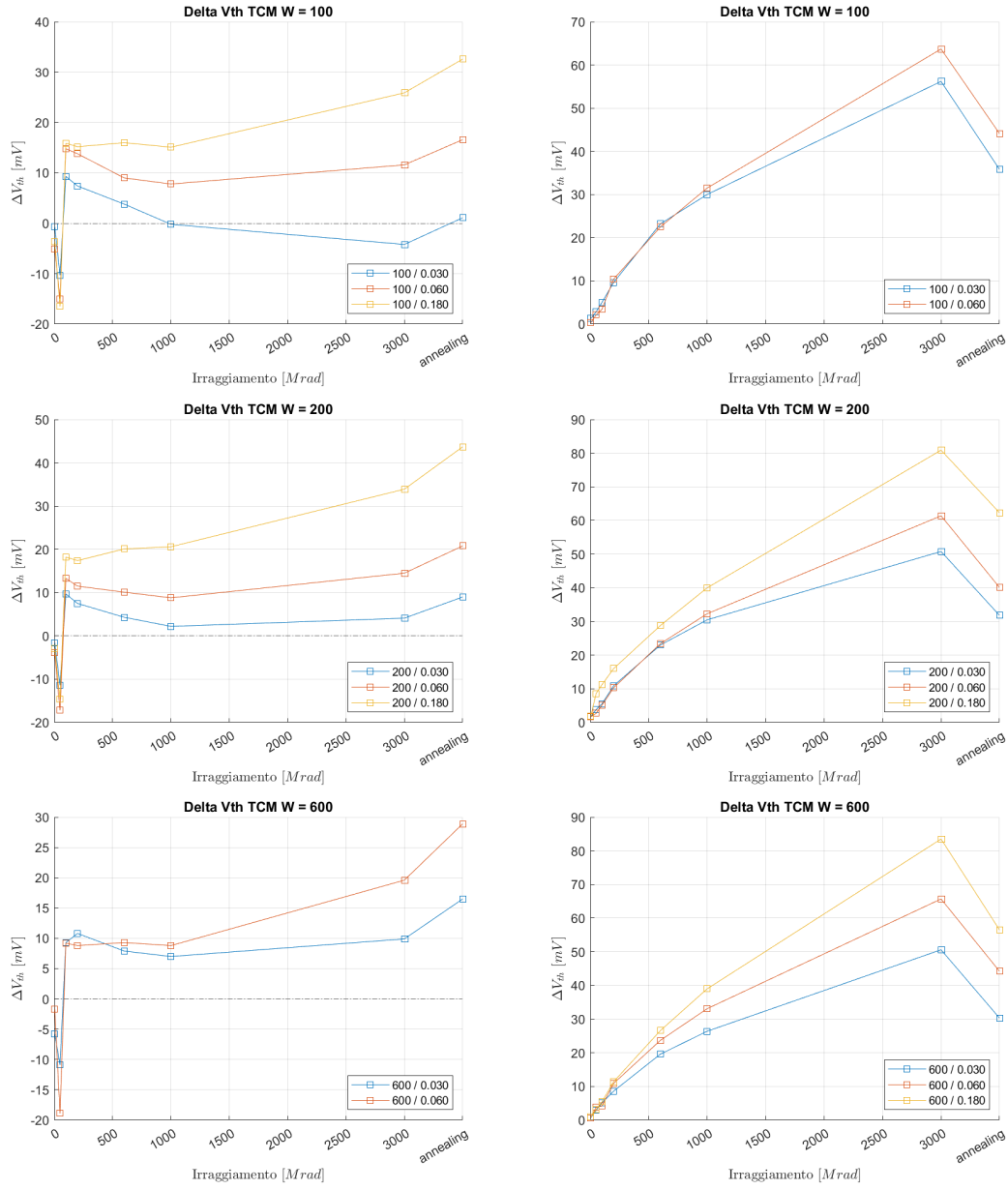


Figura 2.3: Variazioni di  $V_{th}$  dei dispositivi NMOS (a sinistra) e PMOS (a destra) estratte con TCM in funzione della dose assorbita. Ogni figura si riferisce a una larghezza di canale W differente. Raggruppate per dimensione dello spessore dei dispositivi

### 2.1.2 Second Difference of the Logarithm of the drain current Minimum method

Il secondo metodo analizzato è il *Second Difference of the Logarithm of the drain current Minimum method*, *SDLM*. Questo metodo definisce la  $V_{th}$  come la tensione  $V_{GS}$  per la quale si ha il picco minimo della derivata seconda del logaritmo naturale di  $I_D$  ripetuto alla tensione di gate ( $\frac{d^2 \ln I_D}{dV_{GS}^2}$ ) e vale solo per alti valori di  $V_{DS}$ [5].

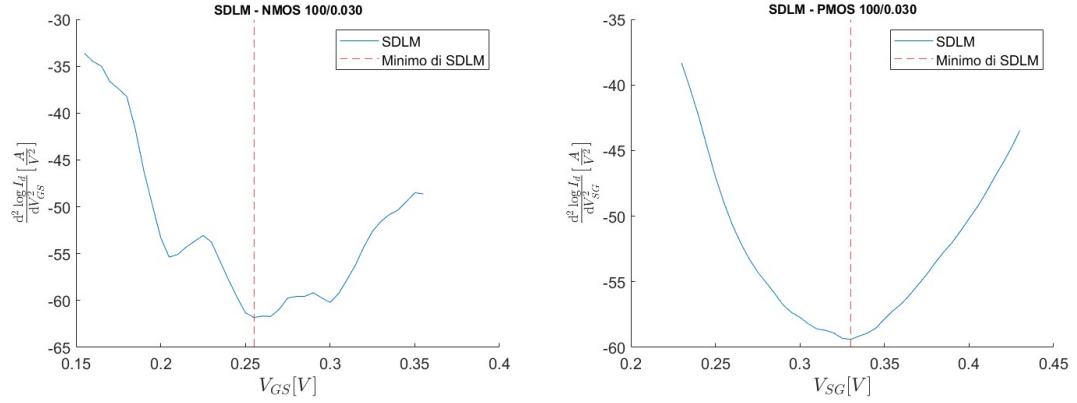


Figura 2.4: Esempio di *SDLM* usato su un dispositivo NMOS e un dispositivo PMOS di dimensioni 100-0.030 a  $V_{DS} = 900mV$

Anche per questo metodo si ritrovano le problematiche presenti per il *TCM*: si deve fare il fit di una curva ottenuta come derivata seconda e inoltre la risoluzione della  $V_{GS}$  è  $5mV$ . Quindi, anche per questo metodo, abbiamo deciso d'interpolare la funzione ottenuta con una polinomiale e considerare il minimo di quest'ultima.

Prendendo in considerazione i dati presenti nella tabella 2.6, si nota come  $V_{th}$  assume valori molto diversi a seconda del grado della polinomiale interpolante. Nella maggior parte dei casi, le tensioni di soglia ottenute con polinomiali di grado basso (2 e 4) cambiano molto tra loro e rispetto a quelle ottenute con polinomiali di grado alto (6 e 8), mentre le misure ottenute con queste ultime sono, in genere, molto simili tra loro. Ad esempio, osservando i grafici relativi alla *SDLM* del PMOS 200-0.030 (figura 2.5), si può notare che il plot della funzione  $\frac{d^2 \ln I_D}{dV_{GS}^2}$  ha un andamento che non viene interpolato in modo preciso da polinomiali di basso grado: per questo i valori minimi si discostano parecchio dai minimi ottenuti con polinomiali di grado maggiore. Risulta pertanto necessario estrarre le tensioni di soglia utilizzando una funzione polinomiale di grado 6.

Di seguito si riportano i valori delle  $V_{th}$  e delle  $\Delta V_{th}$ , per i dispositivi NMOS: tabelle 2.7 e 2.9, e per i PMOS: tabelle 2.8 e 2.10. Mentre in figura 2.6 si riportano i grafici che mostrano l'andamento della variazione della tensione di soglia ( $\Delta V_{th}$ ), in funzione della dose assorbita.



Dispositivo	$V_{th}[mV]$ con interpolante di grado:			
	2	4	6	8
100 - 0.030	332.0	322.3	323.5	327.2
100 - 0.060	423.1	416.1	411.6	411.7
200 - 0.030	303.2	298.8	296.5	296.7
200 - 0.060	413.1	404.4	404.9	405.0
200 - 0.180	460.4	453.5	449.3	448.7
600 - 0.030	296.0	291.4	289.7	298.1
600 - 0.060	398.3	393.3	391.8	389.6
600 - 0.180	454.7	446.7	441.4	441.3

Tabella 2.6: Confronto dei valori di  $V_{th}$  dei dispositivi PMOS ottenuti con *SDLM* con fit polinomiale di diversi gradi

Dispositivo	$V_{th}[mV]$								
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad	3Grad	annealing
100 - 0.030	287.7	259.5	271.2	289.8	287.7	278.5	276.4	269.7	275.0
100 - 0.060	356.8	327.2	322.7	360.9	356.8	356.6	352.6	354.6	352.4
100 - 0.180	404.8	381.5	369.1	422.1	404.8	422.1	418.2	433.1	442.5
200 - 0.030	279.7	262.2	269.6	277.9	279.7	267.3	268.5	267.8	268.2
200 - 0.060	355.3	325.4	313.3	357.4	355.3	351.1	348.7	355.7	358.2
200 - 0.180	417.9	378.9	372.5	418.8	417.9	420.1	416.7	436.6	441.5
600 - 0.060	334.4	276.0	304.0	336.1	334.4	332.7	331.6	333.8	336.7
600 - 0.180	417.1	381.5	379.6	418.4	417.1	416.2	414.3	426.7	431.1

Tabella 2.7:  $V_{th}$  dei dispositivi NMOS estratte con *SDLM*

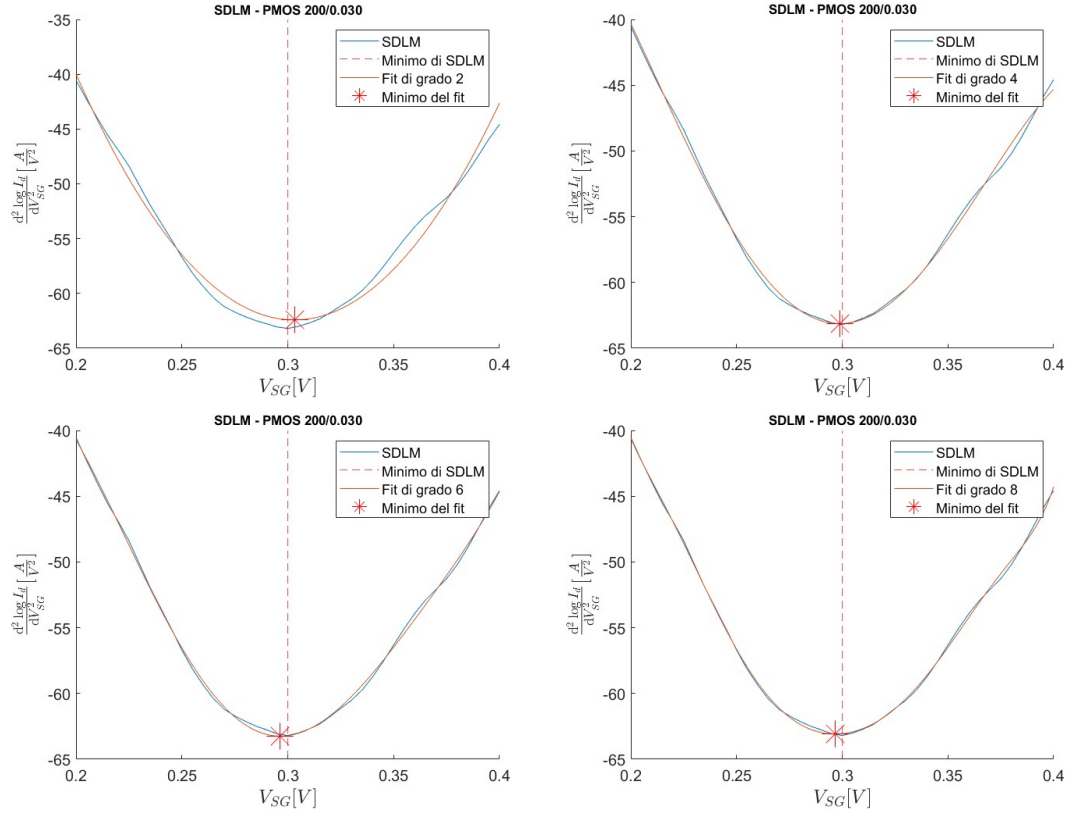


Figura 2.5: Confronto fra differenti fit (al variare del grado della funzione) della curva  $\frac{d^2 \ln(I_D)}{dV_{GS}^2}$  per un dispositivo PMOS 200-0.030.

Dispositivo	$V_{th}[mV]$								
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad	3Grad	annealing
100 - 0.030	323.5	329.9	327.3	330.7	329.7	343.2	355.8	373.1	354.5
100 - 0.060	411.6	409.9	412.3	415.5	416.8	428.3	435.8	466.9	453.9
200 - 0.030	296.5	292.4	301.7	299.8	304.4	320.0	323.0	345.6	327.0
200 - 0.060	404.9	403.9	405.3	407.3	413.0	422.5	430.9	460.0	442.1
200 - 0.180	449.3	452.1	457.6	456.9	461.9	473.7	482.7	520.4	506.6
600 - 0.030	289.7	293.0	297.3	297.0	299.9	313.1	325.7	345.2	324.0
600 - 0.060	391.8	393.4	397.4	396.8	402.0	415.1	421.2	451.1	432.6
600 - 0.180	441.4	443.4	445.1	444.6	450.9	464.5	474.2	514.2	492.4

Tabella 2.8:  $V_{th}$  dei dispositivi PMOS estratte con *SDLM*

Dispositivo	$\Delta V_{th}[mV]$							
	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad	3Grad	annealing
100 - 0.030	-20.2	-8.5	10.1	8.0	-1.2	-3.3	-10.0	-4.7
100 - 0.060	12.1	7.6	45.8	41.7	41.5	37.5	39.5	37.3
100 - 0.180	12.1	-0.3	52.7	35.4	52.7	48.8	63.7	73.1
200 - 0.030	-2.5	4.9	13.2	15.0	2.6	3.8	3.1	3.5
200 - 0.060	-0.6	-12.7	31.4	29.3	25.1	22.7	29.7	32.2
200 - 0.180	7.1	0.7	47.0	46.1	48.3	44.9	64.8	69.7
600 - 0.060	-29.1	-1.1	31.0	29.3	27.6	26.5	28.7	31.6
600 - 0.180	-3.3	-5.2	33.6	32.3	31.4	29.5	41.9	46.3

Tabella 2.9:  $\Delta V_{th}$  dei dispositivi NMOS estratte con *SDLM*

Dispositivo	$\Delta V_{th}[mV]$							
	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad	3Grad	annealing
100 - 0.030	6.4	3.8	7.2	6.2	19.7	32.3	49.6	31.0
100 - 0.060	-1.7	0.7	3.9	5.2	16.7	24.2	55.3	42.3
200 - 0.030	-4.1	5.2	3.3	7.9	23.5	26.5	49.1	30.5
200 - 0.060	-1.0	0.4	2.4	8.1	17.6	26.0	55.1	37.2
200 - 0.180	2.8	8.3	7.6	12.6	24.4	33.4	71.1	57.3
600 - 0.030	3.3	7.6	7.3	10.2	23.4	36.0	55.5	34.3
600 - 0.060	1.6	5.6	5.0	10.2	23.3	29.4	59.3	40.8
600 - 0.180	2.0	3.7	3.2	9.5	23.1	32.8	72.8	51.0

Tabella 2.10:  $\Delta V_{th}$  dei dispositivi PMOS estratte con *SDLM*

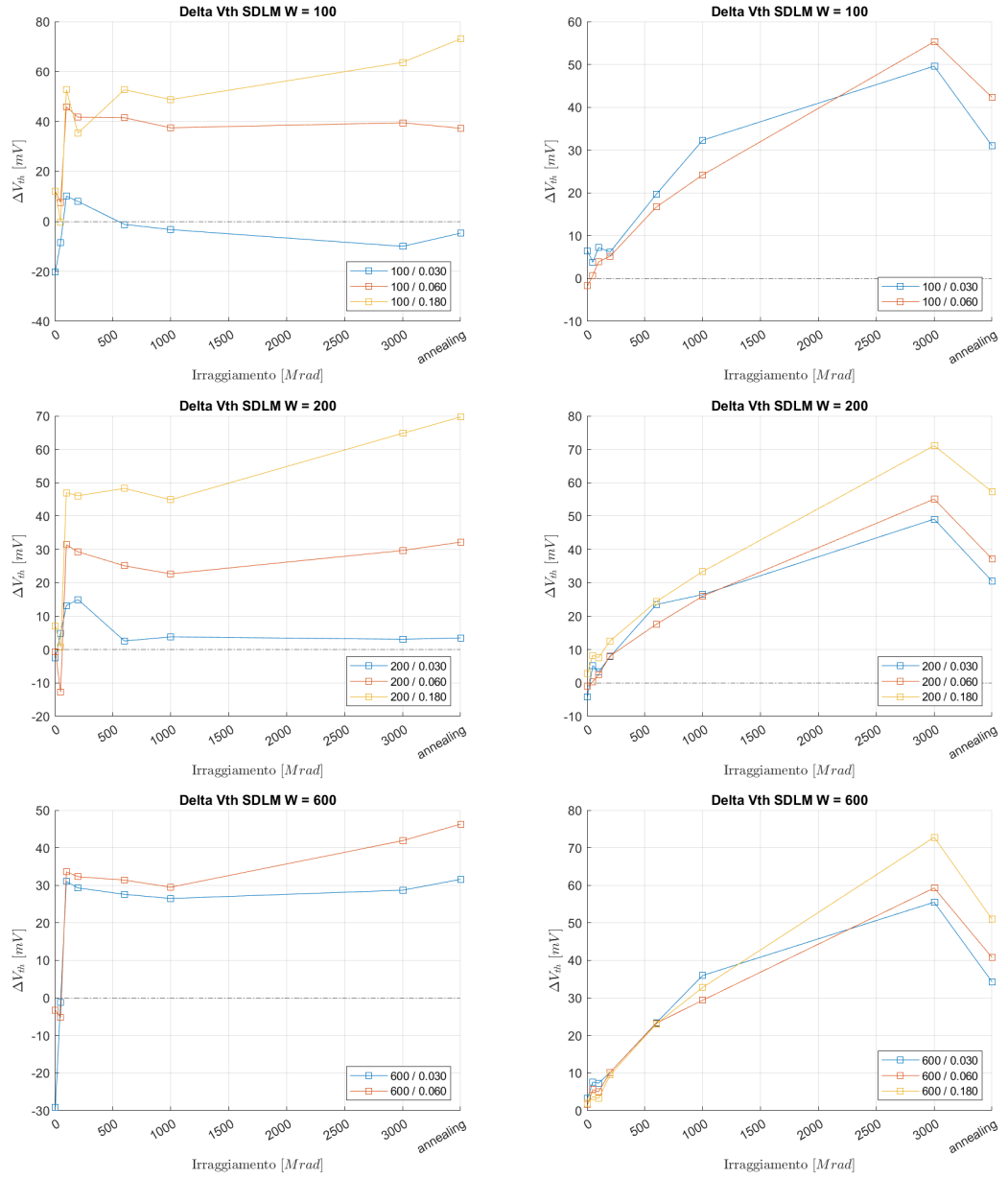


Figura 2.6: Variazioni di  $V_{th}$  dei dispositivi NMOS (a sinistra) PMOS (a destra) estratte con *SDLM* in funzione della dose assorbita. Ogni figura si riferisce a una larghezza di canale  $W$  differente. Raggruppate per dimensione dello spessore dei dispositivi

### 2.1.3 Extrapolation in the Linear Region method

Il terzo metodo analizzato è l'*Extrapolation in the Linear Region method*, *ELR*[4]. La tensione di soglia estratta con questo metodo è data dall'intercetta della estrapolazione

lineare della caratteristica  $I_D - V_{GS}$  nel suo punto di massima pendenza (cioè il punto di massima transconduttanza,  $g_m$ ) con l'asse delle ascisse ( $V_{GS}$ ). Alla tensione così ottenuta, per ottenere la tensione di soglia, si dovrà aggiungere  $V_{DS}/2$ , dove  $V_{DS}$  è la tensione alla quale è stata misurata la caratteristica  $I_D - V_{GS}$  interpolata linearmente. Operativamente, il tratto sul quale fare il fit lineare è ottenuto prendendo un determinato intervallo nell'intorno del punto di flesso della  $I_D - V_{GS}$ .

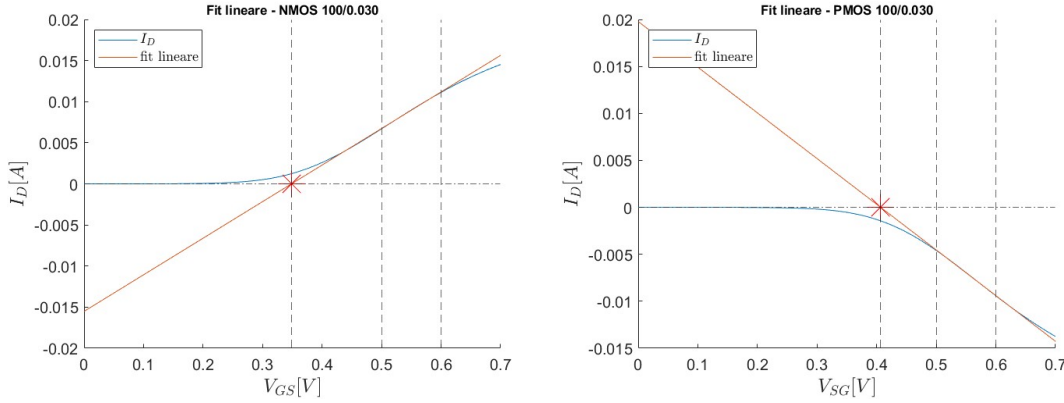


Figura 2.7: Fit lineare della caratteristica  $I_D - V_{GS}$  a  $V_{DS} = 150mV$  di un NMOS e di un PMOS di dimensioni 100-0.030

Lo svantaggio principale di questo metodo è dato dal fatto che il punto di pendenza massima può essere incerto a causa di possibili effetti quali il degrado della mobilità dei portatori di carica e la possibile presenza di resistenze parassite serie al terminale di source e drain. Nonostante ciò, per il nostro studio questo metodo potrebbe risultare efficace, in quanto non siamo principalmente interessati al valore della tensione di soglia dei dispositivi, ma alla variazione della tensione di soglia a causa delle radiazioni ionizzanti alle quali i dispositivi vengono sottoposti. Dunque gli errori prodotti dalle resistenze parassite e dalla degradazione di mobilità possono essere considerate come un offset che viene eliminato nel momento in cui si calcola la differenza tra la  $V_{th}$  pre e post irraggiamento.

È infine doveroso fare una parentesi sulla regione di linearizzazione considerata per questo studio: infatti non è possibile stabilire con certezza una regione fissa in cui la funzione, ottenuta con misure sperimentali, può essere linearizzata. Il metodo da noi applicato è stato quello di analizzare tutti i possibili intervalli di linearizzazione ampi  $100mV$  i cui estremi ricadono nell'intervallo  $[300mV; 750mV]$  e scegliere quello il cui il fit approssimava meglio la funzione. All'atto pratico abbiamo considerato l'intervallo il cui fit ha il coefficiente di determinazione  $R^2$  più alto, che è risultato essere sempre maggiore di 0.999.

## Capitolo 2 Estrazione dei parametri statici

Dispositivo	$V_{th}[mV]$								
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad	3Grad	annealing
100 - 0.030	351.0	348.5	338.8	360.4	358.4	353.1	348.6	346.2	350.1
100 - 0.060	388.8	385.3	373.1	403.8	402.0	398.8	396.0	399.6	404.4
100 - 0.180	465.9	461.6	449.4	482.5	481.7	482.3	481.9	492.9	500.8
200 - 0.030	336.9	334.6	324.6	346.0	344.7	341.3	338.7	340.1	344.5
200 - 0.060	382.9	379.4	366.4	396.6	395.1	393.4	391.6	397.6	403.1
200 - 0.180	454.6	449.8	438.1	471.1	471.0	473.6	474.4	489.5	497.8
600 - 0.060	349.3	347.2	336.7	361.2	361.4	358.1	356.7	359.9	366.0
600 - 0.180	431.8	427.5	412.4	440.6	440.1	440.8	440.4	451.3	460.8

Tabella 2.11:  $V_{th}$  dei dispositivi NMOS estratte con *ELR*

Dispositivo	$V_{th}[mV]$								
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad	3Grad	annealing
100 - 0.030	405.8	406.6	408.6	410.1	416.1	429.3	436.6	458.9	440.7
100 - 0.060	452.0	452.9	454.6	456.5	462.9	475.4	484.9	515.9	497.1
200 - 0.030	376.2	377.6	379.3	380.3	386.9	397.5	404.7	426.3	406.6
200 - 0.060	434.6	435.9	437.5	439.3	445.1	458.1	467.2	495.9	474.2
200 - 0.180	482.3	483.5	490.3	492.4	498.5	511.5	522.6	562.3	543.2
600 - 0.030	359.4	360.9	362.5	364.6	370.1	379.8	387.1	410.6	389.2
600 - 0.060	412.8	414.2	417.1	417.5	424.5	437.3	446.1	477.9	455.5
600 - 0.180	463.2	464.4	466.4	468.9	475.2	490.8	502.9	546.2	519.3

Tabella 2.12:  $V_{th}$  dei dispositivi PMOS estratte con *ELR*

Dispositivo	$\Delta V_{th}[mV]$							
	<i>5Mrad</i>	<i>50Mrad</i>	<i>100Mrad</i>	<i>200Mrad</i>	<i>600Mrad</i>	<i>1Grad</i>	<i>3Grad</i>	annealing
100 - 0.030	-2.5	-12.1	9.4	7.4	2.1	-2.4	-4.8	-0.9
100 - 0.060	-3.5	-15.8	15.0	13.1	10.0	7.2	10.8	15.6
100 - 0.180	-4.3	-16.5	16.6	15.8	16.3	16.0	27.0	34.9
200 - 0.030	-2.3	-12.3	9.1	7.9	4.5	1.8	3.2	7.6
200 - 0.060	-3.5	-16.5	13.6	12.2	10.5	8.7	14.7	20.2
200 - 0.180	-4.9	-16.5	16.5	16.4	19.1	19.8	34.9	43.2
600 - 0.060	-2.2	-12.7	11.8	12.0	8.8	7.4	10.6	16.7
600 - 0.180	-4.3	-19.4	8.8	8.2	9.0	8.6	19.5	29.0

Tabella 2.13:  $\Delta V_{th}$  dei dispositivi NMOS estratte con *ELR*

Dispositivo	$\Delta V_{th}[mV]$							
	<i>5Mrad</i>	<i>50Mrad</i>	<i>100Mrad</i>	<i>200Mrad</i>	<i>600Mrad</i>	<i>1Grad</i>	<i>3Grad</i>	annealing
100 - 0.030	0.8	2.8	4.4	10.4	23.5	30.8	53.1	34.9
100 - 0.060	0.9	2.6	4.5	10.9	23.3	32.9	63.9	45.1
200 - 0.030	1.4	3.2	4.1	10.8	21.3	28.6	50.1	30.4
200 - 0.060	1.3	2.9	4.7	10.5	23.5	32.6	61.3	39.6
200 - 0.180	1.2	8.0	10.1	16.2	29.3	40.4	80.0	60.9
600 - 0.030	1.5	3.2	5.2	10.7	20.4	27.7	51.2	29.8
600 - 0.060	1.4	4.3	4.8	11.8	24.5	33.3	65.1	42.7
600 - 0.180	1.2	3.2	5.7	12.0	27.6	39.7	83.0	56.1

Tabella 2.14:  $\Delta V_{th}$  dei dispositivi PMOS estratte con *ELR*

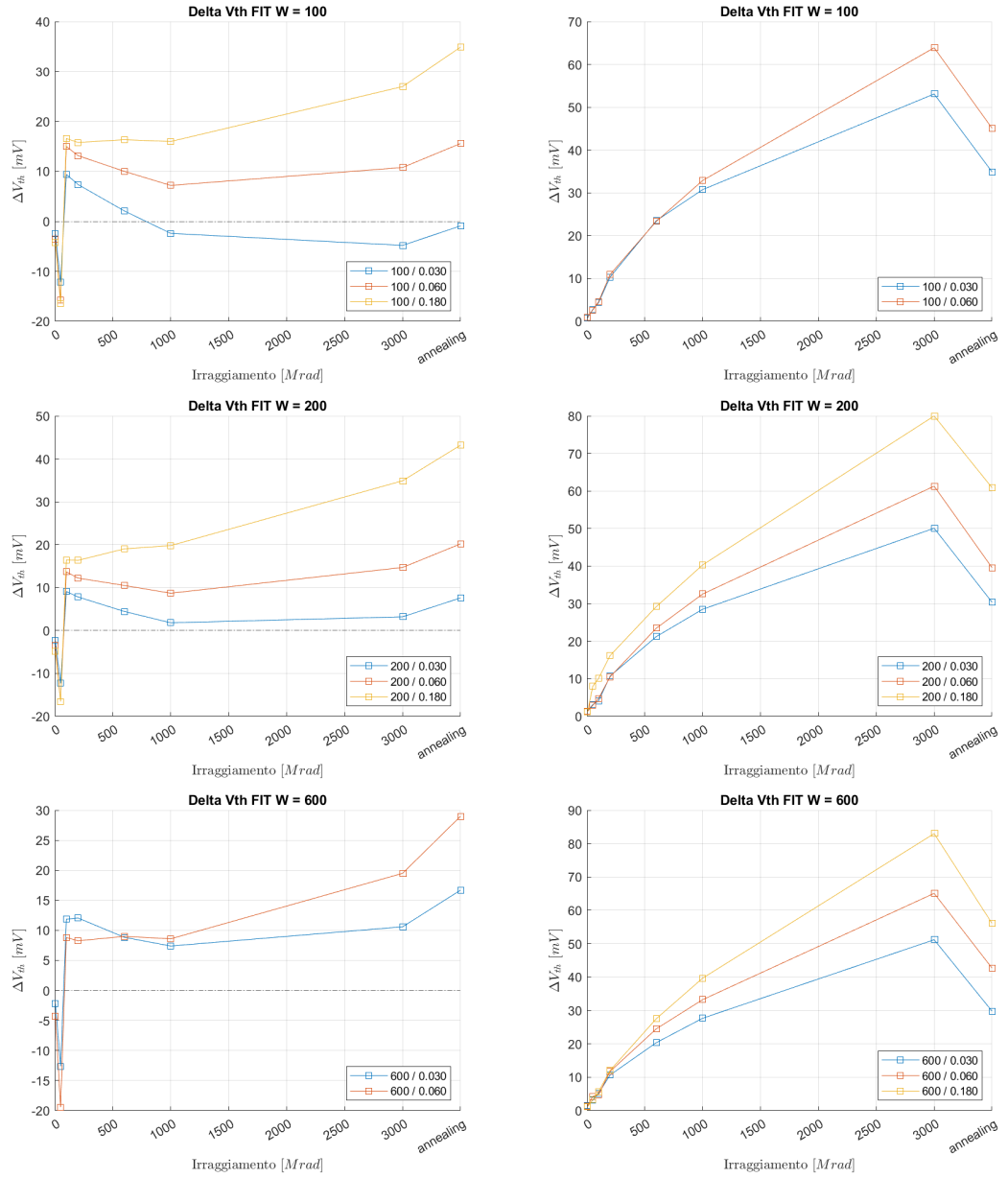


Figura 2.8: Variazioni di  $V_{th}$  dei dispositivi NMOS (a sinistra) PMOS (a destra) estratte con *ELR* in funzione della dose assorbita. Ogni figura si riferisce a una larghezza di canale  $W$  differente.

### 2.1.4 Ratio Method

Il *Ratio Method*, *RM* è stato sviluppato per far fronte alle problematiche dell'*ELR*: è stato infatti dimostrato che questo metodo non è influenzato dalla degradazione della mobilità dei portatori di carica né dalle resistenze parassite[4]. Questo metodo si basa



## 2.1 Tensione di soglia

sull'assunzione che, a bassi valori di tensione di drain  $V_{DS}$ , il rapporto tra la corrente di drain  $I_D$  e la radice quadrata della transconduttanza  $g_m$  ( $\frac{I_D}{\sqrt{g_m}}$ ) in funzione della tensione di gate  $V_{GS}$  si comporti come una funzione lineare. La tensione di soglia  $V_{th}$  coincide con il valore della tensione  $V_{GS}$  a cui il fit lineare della funzione interseca l'asse delle ascisse. Come detto, questo metodo supera alcuni limiti dei metodi descritti in precedenza, però presenta una problematicità non indifferente: tracciando il grafico di  $\frac{I_D}{\sqrt{g_m}}$  in funzione di  $V_{GS}$ , questo non verifica appieno l'assunzione di linearità. Dunque non esiste un intervallo in cui il grafico è chiaramente linearizzabile e quindi la misura di  $V_{th}$  non rispecchia del tutto il valore reale della tensione di soglia, ma è comunque una buona approssimazione, soprattutto se si considera il  $\Delta V_{th}$  al crescere dell'irraggiamento. Anche in questo caso, per ottenere il fit lineare più accurato possibile è stato usato lo stesso metodo esposto per l'*ELR*.

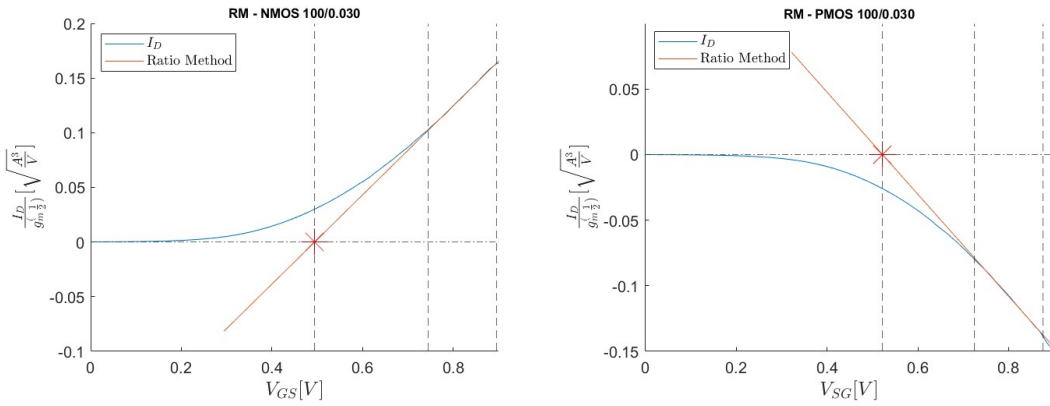


Figura 2.9: Fit lineare della caratteristica  $\frac{I_D}{\sqrt{g_m}} - V_{GS}$  a  $V_{DS} = 150mV$  di un NMOS e di un PMOS di dimensioni 100-0.030

Dispositivo	$V_{th}[mV]$								
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad	3Grad	annealing
100 - 0.030	494.2	490.9	476.2	449.9	447.5	478.7	478.4	444.0	489.9
100 - 0.060	485.6	481.8	470.9	502.5	499.4	500.3	499.4	506.0	506.9
100 - 0.180	529.4	527.8	503.8	541.0	541.9	541.4	540.9	545.8	550.8
200 - 0.030	485.2	497.4	483.1	486.8	496.7	504.1	497.3	500.3	499.0
200 - 0.060	499.8	482.9	467.2	499.6	498.9	503.1	514.1	513.6	518.1
200 - 0.180	523.4	515.8	507.5	542.1	538.6	544.1	546.2	506.6	555.1
600 - 0.060	514.9	507.4	504.9	517.3	521.4	521.2	514.3	512.8	526.5
600 - 0.180	539.0	537.0	525.9	546.6	546.2	545.6	546.1	550.2	557.4

Tabella 2.15:  $V_{th}$  dei dispositivi NMOS estratte con *RM*

Dispositivo	$V_{th}[mV]$								
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad	3Grad	annealing
100 - 0.030	522.3	529.8	530.7	532.2	533.3	544.4	547.3	520.9	553.1
100 - 0.060	543.6	543.3	541.8	545.4	548.9	528.1	541.6	581.5	560.3
200 - 0.030	525.2	520.5	527.4	542.2	544.8	551.1	554.7	554.0	553.5
200 - 0.060	547.9	540.5	549.1	550.6	555.7	563.1	568.3	579.3	571.1
200 - 0.180	551.1	553.1	538.3	538.0	545.0	568.8	576.8	599.7	587.5
600 - 0.030	527.8	539.9	537.3	540.2	539.9	550.8	555.2	567.0	556.5
600 - 0.060	557.2	552.2	558.5	559.7	558.7	567.6	576.7	589.6	575.2
600 - 0.180	555.2	559.3	556.9	559.4	559.7	574.3	581.3	603.4	582.1

Tabella 2.16:  $V_{th}$  dei dispositivi PMOS estratte con  $RM$

Dispositivo	$\Delta V_{th}[mV]$							
	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad	3Grad	annealing
100 - 0.030	-3.3	-18.0	-44.3	-46.7	-15.4	-15.8	-50.2	-4.3
100 - 0.060	-3.9	-14.7	16.8	13.8	14.7	13.8	20.4	21.3
100 - 0.180	-1.6	-25.6	11.6	12.6	12.0	11.5	16.4	21.4
200 - 0.030	12.2	-2.1	1.7	11.5	19.0	12.1	15.1	13.8
200 - 0.060	-16.9	-32.5	-0.2	-0.9	3.3	14.3	13.8	18.3
200 - 0.180	-7.6	-15.9	18.7	15.2	20.7	22.8	-16.8	31.7
600 - 0.060	-7.5	-9.9	2.4	6.5	6.3	-0.6	-2.1	11.6
600 - 0.180	-1.9	-13.0	7.6	7.2	6.7	7.1	11.2	18.4

Tabella 2.17:  $\Delta V_{th}$  dei dispositivi NMOS estratte con  $RM$

Dispositivo	$\Delta V_{th}[mV]$							
	<i>5Mrad</i>	<i>50Mrad</i>	<i>100Mrad</i>	<i>200Mrad</i>	<i>600Mrad</i>	<i>1Grad</i>	<i>3Grad</i>	annealing
100 - 0.030	7.5	8.4	9.9	11.0	22.1	25.1	-1.4	30.8
100 - 0.060	-0.3	-1.8	1.8	11.0	-15.5	-2.0	37.9	16.7
200 - 0.030	-4.7	2.2	17.0	19.6	25.9	29.5	28.8	28.3
200 - 0.060	-7.5	1.1	2.6	7.7	15.2	20.3	31.4	23.2
200 - 0.180	2.0	-12.7	-13.1	-6.1	17.8	25.7	48.6	36.4
600 - 0.030	12.1	9.5	12.4	12.1	23.0	27.5	39.2	28.7
600 - 0.060	12.1	1.3	2.5	12.1	10.4	19.5	32.4	18.0
600 - 0.180	-4.6	1.8	4.3	4.5	19.2	26.1	48.2	26.9

Tabella 2.18:  $\Delta V_{th}$  dei dispositivi PMOS estratte con *RM*

## Capitolo 2 Estrazione dei parametri statici

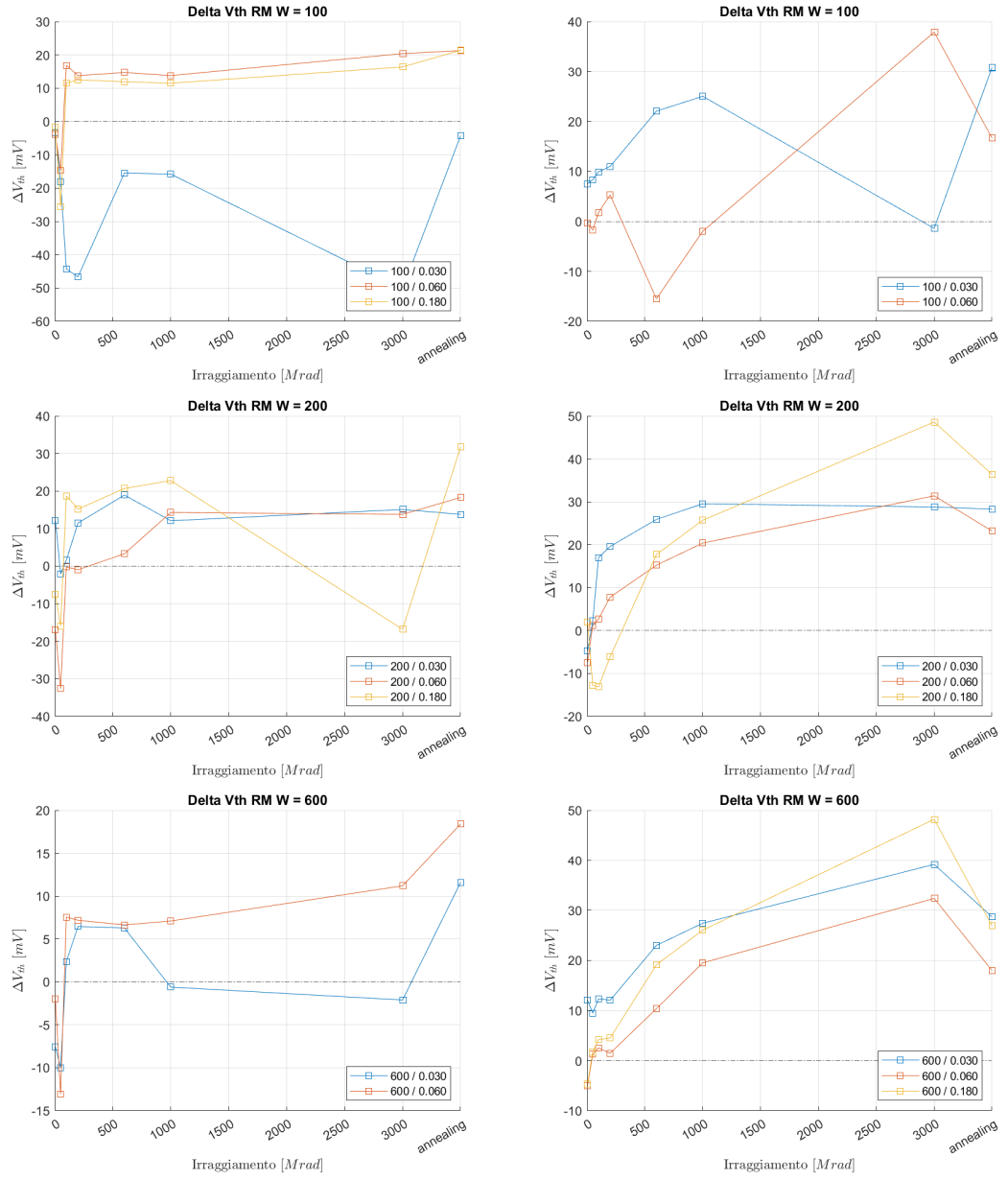


Figura 2.10: Variazioni di  $V_{th}$  dei dispositivi NMOS (a sinistra) PMOS (a destra) estratte con  $RM$  in funzione della dose assorbita. Ogni figura si riferisce a una larghezza di canale  $W$  differente.

## 2.2 Transconduttanza

### 2.3 $G_{ds}$

### 2.4 $I_{on}$

### 2.5 $I_{off}$

## 2.6 Guadagno Intrinseco

Il guadagno intrinseco ( $A_{vi}$ ) è definito come il massimo guadagno ottenibile da un MOSFET, polarizzato da un generatore di corrente ideale. Fornisce una misura di quanto un MOSFET può amplificare senza essere influenzato da elementi esterni, esso viene calcolato come:

$$A_{vi} = g_m \cdot r_0 = \frac{g_m}{g_{ds}}$$

Con  $g_m$  la transconduttanza e  $r_0$  la resistenza in uscita dal transistor ( $1/g_{ds}$ ). Spesso, il grafico di  $A_{vi}$ , viene mostrato in funzione del coefficiente di inversione ( $I_{C0}$ ), parametro utile per descrivere il grado di inversione del canale (debole: per valori inferiori a 0.1, moderata: tra 0.1 e 10, forte: superiori a 10) il quale si può ricavare dalla  $I_d$  ad alte  $V_{ds}$ :

$$I_{C0} = \frac{I_d}{I_z^*} \cdot \frac{L}{W}$$

La corrente caratteristica ( $I_z^*$ ) è stata misurata pre-irraggiamento. I valori sono riportati nella tabella 2.19.

Tipologia Canale	$I_z^*$
N	470nA
P	370nA

Tabella 2.19: Valori della corrente caratteristica misurati prima dell'irraggiamento

Nelle figure 2.11 e 2.12 (NMOS e PMOS) vengono mostrati i grafici  $A_{vi} - I_{C0}$ , raggruppati per larghezza di canale, prima e dopo l'irraggiamento a 3Grad.

Mentre nei NMOS si nota un innalzamento significativo della curva  $A_{vi} - I_{C0}$ , soprattutto per lunghezze di canale più grandi. Questo non sembra verificarsi per i PMOS, infatti, l'offset della curva è leggermente negativo rispetto ai rispettivi grafici pre-irraggiamento. Effetto più visibile per le lunghezze di canale più grandi.

Dare una spiegazione a questo effetto(?), e magari riscriverla meglio XD

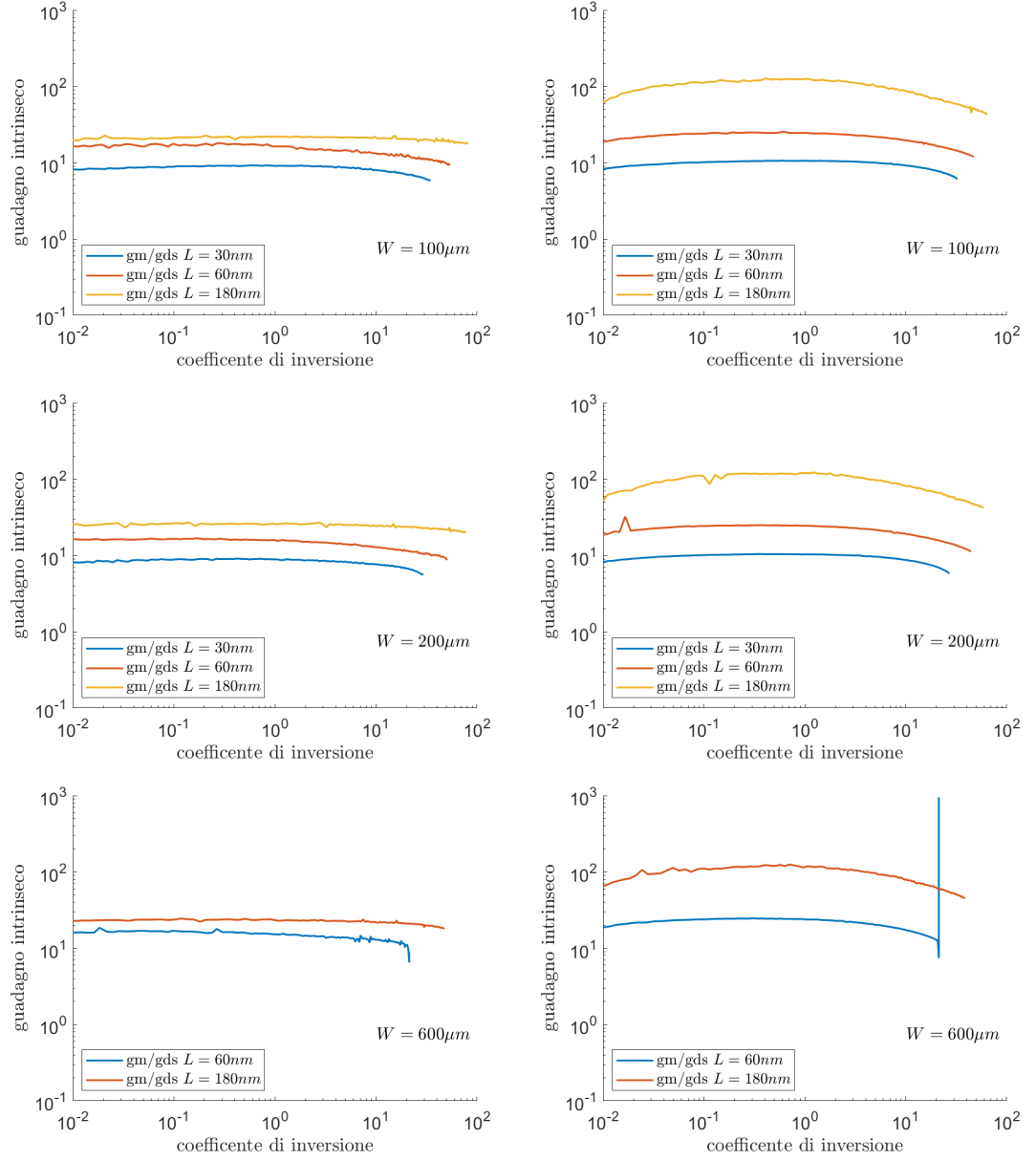


Figura 2.11: Variazioni del guadagno intrinseco per un NMOS, a sinistra pre-irraggiamento mentre a destra dopo una dose di  $3Grad$

## 2.6 Guadagno Intrinseco

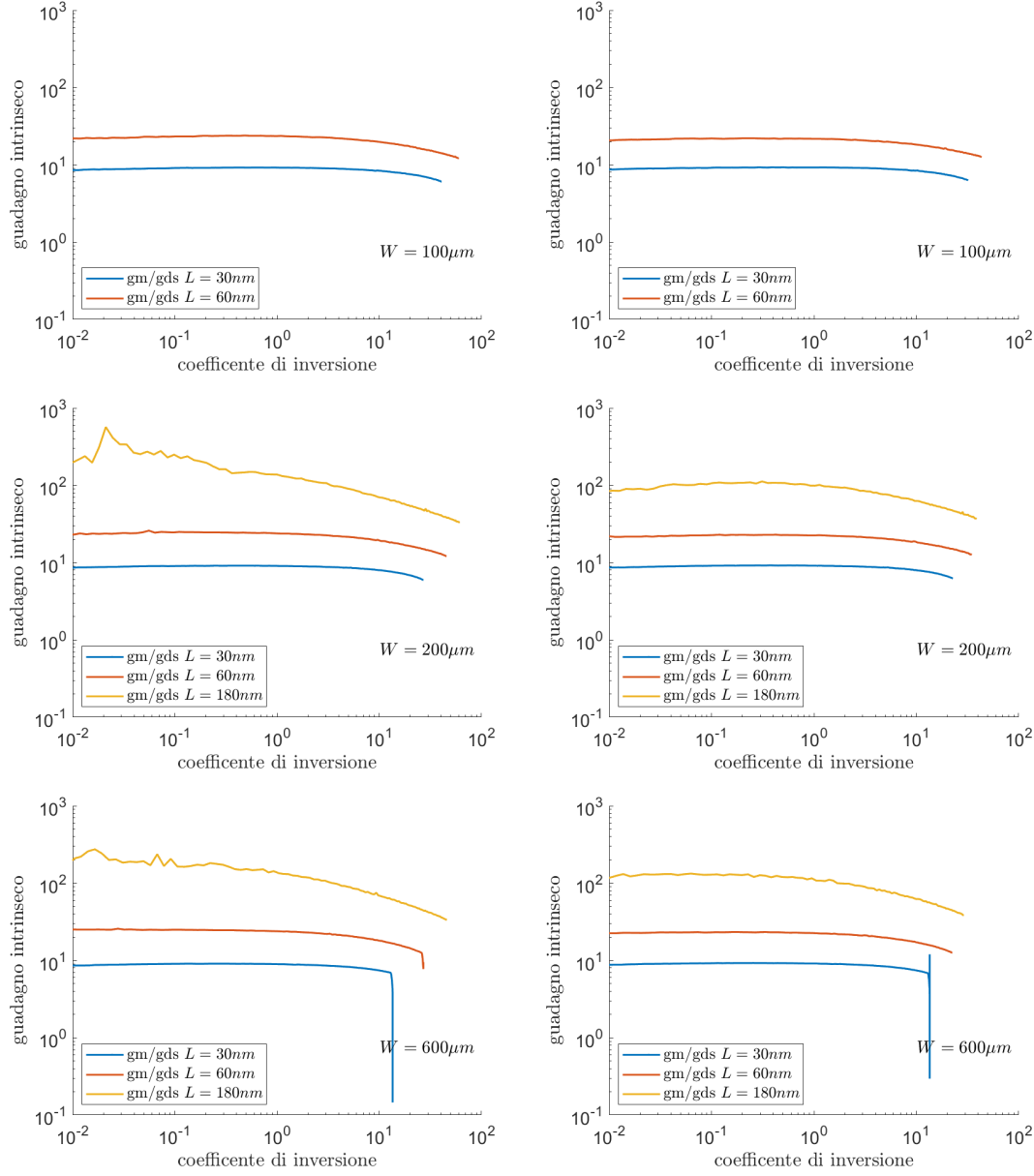


Figura 2.12: Variazioni del guadagno intrinseco per un PMOS, a sinistra pre-irraggiamento mentre a destra dopo una dose di  $3Grad$





# Bibliografia

- [1] L. Edmonds, C. Barnes, L. Scheick, U. S. N. Aeronautics, S. Administration, and J. P. L. (U.S.), *An Introduction to Space Radiation Effects on Microelectronics*, ser. JPL publication. Jet Propulsion Laboratory, National Aeronautics and Space Administration, 2000. [Online]. Available: <https://books.google.it/books?id=3azqHAAACAAJ>
- [2] A. Johnston, “Radiation damage of electronic and optoelectronic devices in space,” in *Proceedings of the 4th International Workshop on Radiation Effects on Semiconductor Devices for Space Application*, 2000, pp. 11–13.
- [3] F. B. McLean and T. R. Oldham, “Basic mechanisms of radiation effects in electronic materials and devices. final report, september 1986-september 1987,” 9 1987. [Online]. Available: <https://www.osti.gov/biblio/5646360>
- [4] A. Ortiz-Conde, F. Garcia Sánchez, J. Liou, A. Cerdeira, M. Estrada, and Y. Yue, “A review of recent mosfet threshold voltage extraction methods,” *Microelectronics Reliability*, vol. 42, no. 4, pp. 583–596, 2002. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026271402000276>
- [5] T. Rudenko, V. Kilchytska, M. K. M. Arshad, J.-P. Raskin, A. Nazarov, and D. Flandre, “Influence of drain voltage on mosfet threshold voltage determination by transconductance change and gm/id methods,” in *Ulis 2011 Ultimate Integration on Silicon*, 2011, pp. 1–4.